

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 8 月 23 日 (23.08.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/60938 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C09J 163/00, [JP/JP]; 〒163-0449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).
7/00, H01L 21/52 // 23/14
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/01065
- (22) 国際出願日: 2001 年 2 月 15 日 (15.02.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2000-41346 2000 年 2 月 15 日 (15.02.2000) JP
特願2000-349737
2000 年 11 月 16 日 (16.11.2000) JP
特願2000-349739
2000 年 11 月 16 日 (16.11.2000) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.)
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 稲田 禎一 (INADA, Teiichi) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 松代ハウス B-108 Ibaraki (JP). 住谷 圭二 (SUMIYA, Keiji) [JP/JP]; 〒312-0063 茨城県ひたちなか市田彦 1313-2 Ibaraki (JP). 富山 健男 (TOMIYAMA, Takeo) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 松代ハウス B-408 Ibaraki (JP). 岩倉 哲郎 (IWAKURA, Tetsuro) [JP/JP]; 〒300-3261 茨城県つくば市花畑1-15-18 紫峰寮 B-408 Ibaraki (JP). 川上 広幸 (KAWAKAMI, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒300-3261 茨城県つくば市花畑1-15-18 紫峰寮 B-407 Ibaraki (JP). 鈴木 雅雄 (SUZUKI, Masao) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-18-2 松代レジデンス I203 Ibaraki (JP). 松崎 隆行 (MATSUZAKI, Takayuki) [JP/JP]; 〒299-0125 千葉県市原市有秋台西2-5 C-15-205 Chiba (JP). 細川 羊一 (HOSOKAWA, Youichi) [JP/JP]; 〒

[続葉有]

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, ADHESIVE FILM MADE WITH THE SAME, SUBSTRATE FOR SEMICONDUCTOR MOUNTING, AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、その製造方法、これを用いた接着フィルム、半導体搭載用基板及び半導体装置

(57) Abstract: An adhesive composition which comprises (a) an epoxy resin, (b) a hardener, and (c) a polymer incompatible with the epoxy resin and optionally contains (d) a filler and/or (e) a curing accelerator; a process for producing an adhesive composition which comprises mixing (a) an epoxy resin with (b) a hardener and (d) a filler and then mixing the resultant mixture with (c) a polymer incompatible with the epoxy resin; an adhesive film obtained by forming the adhesive composition into a film; a substrate for semiconductor mounting which comprises a wiring board and the adhesive film disposed thereon on its side where chips are to be mounted; and a semiconductor device produced with the adhesive film or the substrate.

(57) 要約:

本発明は、(a) エポキシ樹脂、(b) 硬化剤、及び(c) エポキシ樹脂と非相溶性である高分子化合物からなり、更に、必要に応じて(d) フィラー及び/又は(e) 硬化促進剤を含有する接着剤組成物;

(a) エポキシ樹脂及び(b) 硬化剤と(d) フィラーを混合した後、それらの混合物に(c) エポキシ樹脂と非相溶性である高分子化合物を混合することからなる接着剤組成物の製造方法;

前記接着剤組成物をフィルム状に形成してなる接着フィルム;

配線基板のチップ搭載面に前記接着フィルムを備える半導体搭載用基板;並びに

前記接着フィルム又は半導体搭載用基板を用いる半導体装置を開示する。



299-0127 千葉県市原市桜台 1-4-86 Chiba (JP). 畠山恵一 (HATAKEYAMA, Keiichi) [JP/JP]; 〒305-0035 茨城県つくば市松代3-4-1 松代ハウスB-209 Ibaraki (JP). 島田 靖 (SHIMADA, Yasushi) [JP/JP]; 〒300-2655 茨城県つくば市島名 664 Ibaraki (JP). 田中裕子 (TANAKA, Yuuko) [JP/JP]; 〒304-0031 茨城県下妻市高道祖2637-1 サンヒル6-102 Ibaraki (JP). 栗谷弘之 (KURIYA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒308-0000 茨城県下館市幸町3-28-12 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: 弁理士 津国 肇 (TSUKUNI, Hajime); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 SVAX TSビル Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AU, BA, BB, BG, BR, BZ, CA, CN, CR, CU, CZ, DM, DZ, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MG, MK,

MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ZA.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。